

V9

免洗焊膏

无空洞是最好的空洞解决方案



新产品

主要特点

- ▶ 低至无空洞；BGA 元器件为 <1%，BTC 元器件为 <5%
- ▶ 符合 REACH 和 RoHS 标准
- ▶ 面积比小于 0.66 时，可稳定印刷
- ▶ 焊后残留物透明、引脚可测试、高可靠性
- ▶ 12 小时以上稳定的印刷性能
- ▶ 可提供 SAC305 T4 合金焊料

想要消除空洞吗？

V9 能够在 BTC 组件上实现超低 / 无空洞，且无需真空回流。



Solder plus Support

V9 低空洞免洗焊锡膏 专为降低所有元器件上的空洞而开发，如 QFN、LGA、BGA、D-PAK 和其他无真空回流的空洞敏感型元器件。V9 可将 BGA 上的空洞率降低至 1%，BTC 上的空洞率降低至 $< 5\%$ ，同时当面积比 < 0.66 的情况下，提供 12 小时稳定的微小间距印刷性能。其残留物透明，易于引脚测试，并具有高 SIR 特性，非常适合高可靠性的应用。V9 低空洞焊锡膏可提供 SAC305 T4 型号，并且兼容 AIM 大多数免洗的焊锡膏工艺。使用 AIM 的 V9 焊锡膏，在不影响印刷性能的情况下可大幅减低空洞率。

④ **V9 无空洞是最好的空洞解决方案。**

请联系 AIM 销售代表立即获取免费样品。

V9 低空洞焊锡膏
空洞: $\leq 1\%$

典型的竞争对手焊锡膏
空洞: $\geq 9\%$ 以上

